

天津金海通半导体设备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元（不含税）后，实际募集资金金额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 39,273.72 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 32,825.31 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

□□	□□	□□
□□□□□□	A	74,681.19
□□□□□□□□	B1	34,916.56
□□□□□□□□□□□□	B2	4,357.16
□□□□□□□□□□□□□□	B3	3,800.00
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	B4	1,217.84
□□□□□□□□	C=A-B1-B2-B3+B4	32,825.31
□□□□□□□□	D	32,825.31
□□	E=D-C	0

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金存储银行名称	账户	期末余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	320,848,814.63
2	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	7,233,431.95
3	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995	155,407.74
4	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	15,448.52
合计			328,253,102.84

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 39,273.72 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司已于 2023 年 3 月置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,357.16 万元。本次置换已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2023]361Z0247《关于天津金海通半导体设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2024 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率(%)	实际收益或损失
上海浦东发展银行天津科技支行	券商理财产品	50,000,000.00	2023/8/4	2024/2/2	1.00	249,315.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	90,000,000.00	2023/10/23	2024/1/23	2.53	573,750.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	207,000,000.00	2024/1/10	2024/2/8	2.43	400,200.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	70,000,000.00	2024/1/29	2024/2/29	2.40	142,916.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024/1/11	2024/2/21	2.20	108,734.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	250,000,000.00	2024/2/26	2024/3/26	2.57	510,416.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024/2/29	2024/4/3	2.30	94,268.49
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	70,000,000.00	2024/3/1	2024/3/29	2.38	127,944.44
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024/4/7	2024/5/7	2.48	551,250.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024/4/11	2024/5/22	2.20	108,734.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024/5/10	2024/5/31	2.17	337,050.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	300,000,000.00	2024/6/3	2024/6/28	2.38	489,583.33
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	38,000,000.00	2024/5/28	2024/7/1	2.10	74,334.25

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况。

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、

完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				74,681.19		本报告期投入募集资金总额						3,795.56	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						39,273.72	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	不适用	43,615.04	不适用	43,615.04	3,221.01	12,505.70	-31,109.34	28.67	2026年10月	不适用	不适用	否	
年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	不适用	11,066.15	不适用	11,066.15	12.07	6,670.56	-4,395.59	60.28	2025年11月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	562.48	20,097.46	97.46	100.49[注1]	/	/	/	/	
合计	/	74,681.19	/	74,681.19	3,795.56	39,273.72	-35,407.47	/	/	/	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目稳								

	步实施，降低募集资金使用风险，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。